(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-311953 (P2001-311953A)

(43)公開日 平成13年11月9日(2001.11.9)

(51) Int.Cl.'		識別記号		FΙ					テーマコート* (名	· 多考)
G 0 2 F	1/1339	505		G 0	2 F	1/1339		505	2H08	3 9
C 0 8 G	59 /22			CO	8 G	59/22			2H09	9 0
	59/40					59/40			4 J 0 (2
C 0 8 K	3/00			C 0	8 K	3/00			4J03	3 6
	5 /24					5/24 .				
			審査請求	未請求	節以	表項の数7	OL	(全 12 頁)	最終頁	〔に続く
(21)出廢番号	 }	特顏2000-131855(P2000-131855)		(71)	出魔	人 000006	747			
				' '			社リコ・			
(22) 出願日		平成12年4月28日(200	0. 4. 28)					中馬込1丁目	13.飛6.早	
				(72)	発明:		人よさ` ▲まさ`		0 110 11	
								· 12 中馬込 1 丁目	3番6号	梅式
						会社リ		1	ОДОЛ	PRIV
				(72) §	発明					
						東京都	大田区中	中馬込1丁目	3番6号	株式
						会社リ			о ш о - у	PI-24

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 無溶剤型プラスチックフィルム液晶索子用シール剤及び表示案子

(57) 【要約】

Ac. .

【課題】 作業性の良好な、プラスチックフィルム基板 に対する接着強度に優れ、基板の熱変化に対する追従 性、液晶、水分、熱等に対する物理的・化学的安定性の 良好な、硬化時及び硬化後の滲み、膨潤を防止した信頼 性の高い無溶剤型プラスチックフィルム液晶素子用シー ル剤及びそれを用いた液晶表示素子を提供する。

【解決手段】 無溶剤型プラスチックフィルム液晶素子 用シール剤は、エポキシ樹脂、潜在性硬化剤及び充填剤 を主成分として含有する無溶剤型プラスチックフィルム 液晶素子用シール剤であり、該プラスチックフィルム液 晶素子用シール剤硬化後の溶媒抽出における不純物濃度 が0.1 重量%未満であるように構成する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 エポキシ樹脂、潜在性硬化剤及び充填剤を主成分として含有する無溶剤型プラスチックフィルム液晶素子用シール剤であり、該プラスチックフィルム液晶素子用シール剤硬化後の溶媒抽出における不純物濃度が0.1 重量%未満であることを特徴とする無溶剤型プラスチックフィルム液晶素子用シール剤。

【請求項2】 エポキシ樹脂、潜在性硬化剤及び充填剤を主成分として含有する無溶剤型プラスチックフィルム液晶素子用シール剤であり、該プラスチックフィルム液晶素子用シール剤硬化後の溶媒抽出における膨潤率が10重量%以下であることを特徴とする無溶剤型プラスチックフィルム液晶素子用シール剤。

【請求項3】 請求項1乃至請求項2のいずれかに記載の潜在性硬化剤が少なくとも2塩基酸ジヒドラジドを含有することを特徴とする無溶剤型プラスチックフィルム液晶素子用シール剤。

【請求項4】 請求項1乃至請求項2のいずれかに記載の潜在性硬化剤が少なくとも1、3ービス(ヒドラジノカルボエチル)-5ーイソプロピルヒダントインを含有することを特徴とする無溶剤型プラスチックフィルム液晶素子用シール剤。

【請求項5】 請求項1から請求項4のいずれかに記載のエポキシ樹脂が少なくとも可撓性エポキシ樹脂を含有することを特徴とする無溶剤型プラスチックフィルム液晶素子用シール剤。

【請求項6】 請求項5記載の可撓性エポキシ樹脂が少なくとも両末端にグリシジル基を有し、分子中に(R-O)n基(但し、Rはアルキレン基、nは1以上を示す)を少なくとも1つ以上有するエポキシ化ポリエーテルグリコールを含有するエポキシ樹脂であり、潜在性硬化剤と配合することを特徴とする無溶剤型プラスチックフィルム液晶素子用シール剤。

【請求項7】 請求項1から請求項6のいずれかに記載の無溶剤型プラスチックフィルム液晶素子用シール剤を用いた液晶表示素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラスチックフィルム基板を使用する液晶表示素子に用いられるシール剤及びそれを用いた液晶表示素子に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示素子の基板としては、従来から主としてガラス基板が用いられたが、近年、軽量化、大型化、強度の改善あるいは曲面表示の必要性などの観点から、可撓性を有するプラスチックフィルムを基板とした液晶表示素子が注目されている。プラスチックフィルム基板液晶表示素子においては、通常のガラス基板液晶表示素子と同様に、極めて高度な物性が要求される。すなわち、セルを構成している材料同士が強固に結合さ

れ、高い気密性能を保有していなければならず、また、 水分、熱等に対する物理的・化学的安定性にも優れたも のでなくてはならない。このような接着においてガラス 基板を用いた液晶表示素子の場合、潜在性硬化剤を用い たエポキシ系シール剤、低融点ガラス等の無機系シール 剤が使用されており、満足のいくシー**ル特性**が得られて いる。しかし、これらのシール剤は硬化温度150~1 80℃という高温処理を必要とするため、プラスチック フィルム基板に適用した場合には、基板が処理温度に耐 えることができず変形してしまうという問題がある。ま た、硬化物がプラスチックフィルムに対して十分な接着 強度が得られないという問題もある。また、プラスチッ クフィルム基板に適用した低温硬化を目指したシール剤 は、単純に従来の液晶シール材に促進剤を増量したもの が多く、保存安定性及び電気的信頼性に劣るものが多 く、未だ優れた特性を持つシール剤は得られていない。 例えば、プラスチックフィルム基板液晶表示素子用のシ ール剤として、付加重合タイプのシリコーン系シール剤 が提案されている。このシリコーン系シール剤は、プラ スチックフィルムに対する接着性に優れ、フレキシビリ ティーの高い液晶パネルを実現できる。しかしながら、 シリコーン系材料は、ガスや水蒸気をよく通す性質があ るため、高蒸気圧の液晶成分を透過し、特に高温信頼性 に問題がある。特開昭60-26081号公報には、ウレタン結 合を有するエポキシ樹脂、分子中に水酸基を有するエポ キシ樹脂、イソシアネート化合物、極性溶媒および吸湿 性の少ない溶媒の混合溶媒とからなるプラスチック液晶 表示素子用シール剤が提案されているが、極性溶媒の吸 湿性のためにイソシアネート化合物を使用する際の作業 環境に制約があり、また、溶媒を蒸発させてから貼合せ る必要があることから工程数が増加するという問題があ る。他にもプラスチックフィルム基板液晶表示素子用の シール剤としては、例えば、特開昭57-326**69**号公報には 熱可塑性樹脂ワニスで基材表面を溶解して、熱圧着する タイプ、特開昭60-69634号公報には内側がシリコーン系 樹脂で外側がエポキシ系樹脂という二重接着構造にした タイプ、特開平1-129232号公報には光と整を併用硬化 させるタイプなどが提案されているが、未だ欠点が多 い。また、ゴム変性エポキシ樹脂を添加することで、可 撓性を与え、プラスチックフィルム基板へ**の**接着強度を 増加させる試みもあるが、シール剤粘度が高くなり、充 填剤の添加量**が**少なくなり、スクリーン印**刷性**を損な い、更に加熱硬化時に滲みを生じるという問題もある。 また、液晶セルの信頼性を低下させ、硬化物が膨潤し、 接着強度を劣化させるものもある。シール剤組成物中の 液晶表示索子への影響も最近は考慮されてきており、例 えば、特開平6-73164号公報では電気的信頼性向上や滲 み防止のためにエポキシ樹脂、有機ヒドラジド化合物、 ゴム、充填剤、溶剤の液晶封止用樹脂組成物の不純物濃 度を1重量%未満と規定しているものもある。しかし、

*c...

ŧ

プラスチックフィルム液晶用シール剤の場合、シール剤に溶剤が混入していると、プラスチックフィルム基板によっては溶剤に影響を及ぼされるものもあり好ましくはない。また、溶剤を使用するとシール剤組成から溶剤を完全に揮発させる高い温度での溶剤乾燥を行う必要があり、プラスチックフィルム基板に歪みが生じる可能性や製造工程が一工程増加しコストアップにもつながる。乾燥温度が低いと硬化後の組成物に溶剤が不純物として残る可能性が高い。 (無溶媒型シール剤であれば、不純物として残る溶剤を考慮せずとも良く、硬化物の不純物濃度を更に低減することが可能となる)

また、最近では表示機能の多様化と種々使用環境に対応するために高信頼性に更に厳しい要求をされてきており、上記のようなシール剤は不十分であるという問題もある。つまり、セルギャップ縮小化、パネルの大型化への移行などの要求により、より高信頼性を有し、液晶、水分、熱等に対する物理的・化学的安定性の良好な、滲みの少ないシール剤が求められている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、作業性の良好な、プラスチックフィルム基板に対する接着強度に優れ、基板の熱変化に対する追従性、液晶、水分、熱等に対する物理的・化学的安定性が良好で、硬化時及び硬化後の滲み、膨潤を防止した信頼性の高い無溶剤型プラスチックフィルム液晶素子用シール剤及びそれを用いた液晶表示素子を提供することを目的とする。

[0004]

4...

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、 エポキシ樹脂、潜在性硬化剤及び充填剤を主成分として 含有する無溶剤型プラスチックフィルム液晶素子用シー ル剤であり、該プラスチックフィルム液晶素子用シール 剤硬化後の溶媒抽出における不純物濃度が0. 1 重量%未 満であるように構成する。請求項2記載の発明は、エポ キシ樹脂、潜在性硬化剤及び充填剤を主成分として含有 する無溶剤型プラスチックフィルム液晶素子用シール剤 であり、該プラスチックフィルム液晶素子用シール剤硬 化後の溶媒抽出における膨潤率が10重量%以下であるよ うに構成する。請求項3記載の発明は、請求項1乃至請 求項2のいずれかに記載の潜在性硬化剤が、少なくとも 2塩基酸ジヒドラジドを含有するように構成する。請求 項4記載の発明は、請求項1乃至請求項2のいずれかに 記載の潜在性硬化剤が少なくとも1.3-ビス(ヒドラ ジノカルボエチル) -5-イソプロピルヒダントインを 含有するように構成する。請求項5記載の発明は、請求 項1から請求項4のいずれかに記載のエポキシ樹脂が少 なくとも可撓性エポキシ樹脂を含有するように構成す る。請求項6記載の発明は、請求項5記載の可撓性エポ キシ樹脂が少なくとも両末端にグリシジル基を有し、分 子中に(R-O)n基(但し、Rはアルキレン基、nは 1以上を示す)を少なくとも1つ以上有するエポキシ化

ポリエーテルグリコールを含有するエポキシ樹脂であり、潜在性硬化剤と配合するように構成する。請求項7記載の発明は、請求項1から請求項6のいずれかに記載の無溶剤型プラスチックフィルム液晶素子用シール剤により構成する。

[0005]

【発明の実施の形態】以下、本発明を具体的に説明す る。本発明に使用されるエポキシ樹脂としては、一般的 に液状であれば良く、例えばビスフェノールA型エポキ シ樹脂、アルキル置換ピスフェノールA型エポキシ樹 脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、アルキル置換ビ スフェノールF型エポキシ樹脂、ピスフェノールS型エ ポキシ樹脂、水添ピスフェノールA型エポキシ樹脂、グ リシジルアミン型エポキシ樹脂、フェノールノボラック 型エポキシ樹脂、グリシジルエステル型エポキシ樹脂、 脂環式エポキシ樹脂、ウレタン変性エポキシ樹脂、ポリ スルフィド変性エポキシ樹脂、ゴム変性エポキシ樹脂、 ポリアルキレングリコール型エポキシ樹脂等が挙げられ る。特にこれらに限定されるわけではない。これらは単 独で用いても、混合して用いても良い。なお、無溶媒型 プラスチックフィルム液晶素子用シール剤であるため、 これらエポキシ樹脂は液状エポキシ樹脂である。また、 その内、可撓性エポキシ樹脂としては、ウレタン変性エ ポキシ樹脂、ポリスルフィド変性エポキシ樹脂、ゴム変 性エポキシ樹脂(CTBN、ATBN等による変性)、 ポリアルキレングリコール型エポキシ樹脂、エーテルエ ラストマー添加ビスフェノールA型エポキシ樹脂、液状 ウレタン樹脂添加ビスフェノールA型エポキシ樹脂等が 挙げられる。可撓性エポキシ樹脂はこれらに限定される ものではない。これらは単独で用いても、混合して用い ても良い。可撓性エポキシ樹脂を用いた場合、特に硬化 物が他のエポキシ樹脂に比べ、可撓性があるため、接着 強度が高くなる。また、ビスフェノール系エポキシ樹脂 にエーテルエラストマー添加、液状ウレタン樹脂添加の 可撓性エポキシ樹脂は非常に接着強度が大きく、なお且 つ硬化性も高く、耐液晶性に優れた硬化物を与えること が出来る。

【0006】また、可撓性エポキシ樹脂の中でも特に、両末端にグリシジル基を有し、分子中に(R-O)n基で但し、Rはアルキレン基を示す/アルキレン基としては炭素数1~5のもが好ましく、また、繰返し数nd1~25が好ましく、より好ましくはn=2~7である。nが25を越えると柔軟性が大きくなりすぎ、剥離強度保持でなり、プラスチックフィルム液晶表示素子強度保持で必要な強度が不足し、好ましくない)を少なとも1つ以上有するエポキシ化ポリエーテルグリコールを含わて以上有するエポキシ化ポリエーテルグリコールを含っていまで、対象を配合した場合、特にビスフェノール系に比べ、おットライフを長くすることが出来、コストダウンに寄

与することが出来る。また、本発明に使用される硬化剤としては、潜在性硬化剤が使用され、イミダゾールアダクト型硬化剤、ジシアンジアミド変性硬化剤、ジシアンジアミド、ヒドラジド系硬化剤、イミダゾール系硬化剤、アミンアダクト型硬化剤、アミン/酸無水物アダク

H₂NHN-CO- (A) n-CO-NHNH₂ ... (1

【式中Aは、置換基を有することのあるアルキレン基、置換基を有することのあるアリーレン基又はオキソ基を示す。nはO又は1を示す。]で表される2塩基酸ジドラジド等を挙げることができる。上記一般えば、かの2塩基酸ジヒドラジドの具体例としては、例えば、シの2塩基酸ジヒドラジドの具体例としては、例えば、シのウ酸ジヒドラジド、マロン酸ジヒドラジド、アゼライン・フェル酸ジヒドラジド、セバシン酸ジヒドラジド、ドデカンール酸ジヒドラジド、セバシン酸ジヒドラジド、酒を受じた、カーカール酸ジヒドラジド、カーカール酸ジヒドラジド、カーカールでラジド、カーカールできる。

【0007】上記以外の2塩基酸ジヒドラジドとして は、2、4ージヒドラジノー6ーメチルアミノーsym ートリアジン等をも挙げることができる。なお、2塩基 酸ジヒドラジドはこれらに限定されるものではなく、単 独でも混合して使用しても構わない。また、2塩基酸ジ ヒドラジドを用いた場合、基板への接着強度が増加す る。確認はできていないが、基板の表面とジヒドラジド のカルボニル基が水素結合することにより、接着強度が 増加していると考えている。特に1、3ービス(ヒドラ ジノカルボエチル) -5-イソプロピルヒダントイン (以下VDHと略す)を含有する場合、低温硬化**性が**発 現し、プラスチックフィルム基板に対して歪みの生じな い硬化温度でシールでき、好適である。これは、ジヒド ラジドのカルボニル基とヒダントイン環のカルボニル基 があり、1分子当たりのカルボニル基が多く、水素結合 する部位が多いことと、分子鎖が大きいことによるエポ キシ樹脂との架橋間がある程度長くなり、可撓性が付与 され、更に接着強度が増加したと考えている。本発明使 用の2塩基酸ジヒドラジドは、平均粒子径が0.5~2 $0 \, \mu$ m、好ましくは $1 \sim 5 \, \mu$ mの固体ヒドラジドとして 用いられる。O. 5µm未満では、保存安定性が低下す る可能性があり、更に粒子同士の凝集により、取扱が困 難となり好ましくない。一方20μmを越えると、得ら れるエポキシ樹脂の耐熱性、耐湿性、耐水性、電気絶縁 性等が低下し、好ましくない。なお、これら固体ヒドラ ジドを用いることにより、液状硬化剤に比べ保存特性も 良好となり、工程簡略化などのコストダウンにも寄与す ることが出来る。更に本発明においては、随時、硬化促 進剤や充填剤を添加して使用することも出来る。硬化促

4. J.

)-NHNH2 … (1) 進剤としては、具体的には例えば、3級アミン化合物や 尿素化合物や通常潜在性硬化剤として使用されている硬 化剤例えばジシアンジアミド、アミンアダクト化合物や 尿素アダクト化合物などが挙げられる。3級アミン化合物としては、2ーメチルイミダゾール、1、2ージメチルイミダゾール、2、4ージアミノー6ー{2 'ーメチルイミドゾリルー (1')}ーエチルーsートリアジン、2、4ージアミノー6ー{2 'ーメチルイミドゾリルー (1')}ーエチルーsートリアジンイソシアヌル酸付加物などが挙げられ、尿素化合物としては、3-フェニルー1、1-1・ジメチル尿素及び又は 3- pークロロフェニルー1、

1- ジメチル尿索などが挙げられる。更に他の硬化促進

剤潜在性硬化剤として使用されているものも使用でき

ト型硬化剤などが挙げられる。硬化剤はこれらに限定さ

れるものではなく、単独でも混合して使用しても構わな

い。更に本発明に使用される潜在性硬化剤の2塩基酸ジ

ヒドラジドは、具体的には例えば、一般式 (1)

る、例えばジシアンジアミド、アミンアダクト化合物、 尿素アダクト化合物、ポリアミン変性化合物なども挙げ られる。特にこれらに限定されるものではない。 【0008】また、2. 4ージアミノー6ー{2 'ーメ チルイミドゾリルー(1′)}ーエチルーsートリアジ ン、2、4ージアミノー6ー[2 'ーメチルイミドゾリ ルー (1 ˙) }ーエチルーsートリアジンイソシアヌル酸 付加物及びジシアンジアミドの場合、硬化促進化が認め られ、且つ硬化物の耐液晶性が良く、接着強度を高くす ることが出来る。これらは、上記硬化促進剤の中でも特 に耐液晶性が良好で、硬化温度低下をもたらすため、特 に好ましい。また、他の硬化促進剤として、例えば2液 型シール剤に使用されるアミン系の場合、硬化促進効果 は認められるが、硬化物の耐液晶性に劣り、好ましくな い等の問題がある。硬化促進剤の量は、エポキシ樹脂10 0 重量部に対して5重量部以下が好ましい。この量が5 重量部を越えると、硬化性はよいものの、プラスチック フィルム基板への接着強度不足及び耐湿性、耐液晶性等 の信頼性に悪影響を及ぼすことになる。硬化促進剤を添 加することで、硬化温度の低減、硬化時間の短縮を行う ことが出来、コストダウン、セル作製工程の簡素化(セ ル作製時における省エネ)へも寄与することも出来る。 充填剤としてはポリマー粒子や無機充填剤が挙げられ る。ポリマー粒子としては、例えば具体的にはシリコー ンゴム粒子、シリコーン樹脂粒子、ポリエチレン粒子、 ポリプロピレン粒子、ポリ塩化ビニル粒子、ポリメチル メタクリレート粒子、架橋ポリメチルメタクリレート粒 子、ポリn-ブチルアクリレート粒子などのポリアクリ レート系粒子、架橋ポリスチレン粒子、ナイロン12粒 子、メラミン樹脂粒子、ペンゾグアナミン樹脂粒子、メ ラミンーグアナミン樹脂粒子、ポリウレタン樹脂粒子、

ポリ酢酸ビニル粉、ポリスチレンー酢酸ビニル共重合体 粒子、ポリエステル粒子、尿素樹脂粒子、フェノール樹脂粒子、エポキシ樹脂粒子等などが挙げられる。特にこれらに限定されるものではない。ポリマー粒子を使用することで、膨潤ゲル化し、染み出しを防止することができる。

【0009】特に、ポリアクリレート系粒子においては エポキシ樹脂の硬化の際、液状化し、流動性の増したエ ポキシ樹脂を膨潤し、ゲル化し、染み出し防止に寄与す るだけでなく、柔軟性を硬化物に付与することもでき、 プラスチックフィルム基板に対して、接着強度を増加さ せる効果もある。これは、ポリアクリレート系粒子を含 有することで、プラスチックフィルム基板とのSP値が 近くなり、接着性が増したのではないかと考えている。 また、ゴム変性エポキシ樹脂のようにシール剤自体の粘 度を高くしないので、スクリーン印刷性にも優れる。理 由は不明だが、ポリアクリレート系粒子の添加がエポキ シ樹脂の硬化を促進する効果もあり、より低温硬化シー ルを可能にしている。特にコアシェル型(アクリル系あ るいはジェン系重合体のコアにアクリレート系重合体を シェル成分としてコートしたポリマー粒子)ポリアクリ レート粒子、更にはコートしたシェル成分の最外側にイ オン層を形成させたポリアクリレート粒子も挙げられ、 これらはさらに接着強度が強く、染み出し防止に効果が あり、好ましい。ポリマー粒子の添加量としては、染み 出し防止の点などからエポキシ樹脂100重量部に対し て3~40重量部が好ましい。3重量部未満であると、 染み出し防止に効果が見られず、シール性が悪くなる。 また、40重量部を越えると、粘度が高くなり、スクリ 一ン印刷性を損なってしまう。などの問題が出てくる。 なお、混合の際、スクリーン印刷時、スクリーンの目詰 まり防止等のため三本ロール等で混練し、微細化して使 用することが望ましい。無機充填剤としては、炭酸カル シウム、炭酸マグネシウム等の炭酸塩、硫酸パリウム、 硫酸マグネシウム等の硫酸塩、ケイ酸アルミニウム、ケ イ酸ジルコニウム等のケイ酸塩、酸化鉄、酸化チタン、 酸化アルミニウム、酸化亜鉛等の酸化物、カオリン、タ ルク、アスペスト粉、石英粉、雲母、ガラス繊維等が挙 げられる。これらは単独でも混合し使用しても良い。こ れら充填剤の添加量は、本発明に用いるシール剤組成、 特に充填剤そのものの種類により大きく変化するが、エ ポキシ樹脂 100重量部に対して、1~100 重量部が望ま しい。更に硬化物の耐液晶性の面からもこの範囲内が好 ましい。1厘量部未満では、塗布作業性が悪く、塗布さ れたパターンの保持性も劣る等の欠陥を生じやすい。そ の上、耐液晶性が劣化する。100 重量部を越えると、粘 度上昇などによりスクリーン印刷性を損なう。その上、 接着性が劣化する傾向にある。なお、充填剤の混合に当 たっては、スクリーン印刷時、スクリーンの目詰まり防 止等のため三本ロール等で混練し、微細化して使用する

ことが望ましい。 【0010】無機充填剤を使用する際にシランカップリ ング剤及びチタンカップリング剤などを使用することが 望ましい。具体的にはシランカップリング剤としては、 例えば、アーアミノプロピルトリエトキシシラン、Nβー(アミノエチル)-γーアミノプロピルトリエトキ シシラン、Nーβー(アミノエチル)ーγーアミノプロ ピルトリメトキシシラン、N − β − (アミノエチル) − γーアミノプロピルメチルジメトキシシラン、Nーフェ ニルーァーアミノプロピルトリメトキシシラン、ァーユ レイドプロピルトリエトキシシラン等のアミノシランカ ップリング剤、アーグリシドキシプロピルトリメトキシ シラン、βー(3,4ーエポキシシクロヘキシル)エチ ルトリメトキシシラン、ァーグリシジルオキシプロピル トリメトキシシラン、ァーグリシドキシプロピルメチル ジェトキシシラン等のエポキシシランカップリング剤、 ビニルトリクロロシラン、ビニルトリメトキシシラン、 ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス (β-メトキ シエトキシ)シラン等のビニルシランカップリング剤、 アーメルカプトプロピルトリメトキシシラン等のメルカ プトシランカップリング剤、ァーメタクリロイルオキシ プロピルトリメトキシシラン等のアクリルシランカップ リング剤、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエト キシシラン、アークロロプロピルトリメトキシシラン、 トリフルオロメチルトリメトキシシラン等の一般式 R Si(OR')3[式中、Rは1個又は2個以上のハロゲ ン原子が置換してもよい炭素数1~4程度の直鎖又は分 岐鎖状のアルキル基を示し、R'は炭素数1~4程度の 直鎖又は分岐鎖状のアルキル基を示す。〕で表されるア ルキルトリアルコキシシラン等を挙げることができる。 チタンカップリング剤の具体例としては、例えば、イソ プロピルトリイソステアロイルチタネート、イソプロピ ルトリスーイソデシルベンゼンスルホニルチタネート、 イソプロピルトリスー n ーデシルベンゼンスルホニルチ タネート、イソプロピルトリス(ジオクチルピロホスフ ェート)チタネート、テトライソプロピルービス(ジオ クチルホスファイト) チタネート、テトラオクチルーピ ス(ジトリデシルホスファイト)チタネート、テトラ (2. 2ージアリルオキシメチルー1ーブチル)ービス (ジートリデシルホスファイト) チタネート、ビス (ジ オクチルピロホスフェート) オキシアセテートチタネー ト、ビス(ジオクチルピロホスフェート)エチレンチタ ネート、イソプロピルトリオクタノイルチタネート、イ ソプロピルジメタクリルイソステアロイルチタネート、 イソプロピルイソステアロイルジアクリルチタネート、 イソプロピルトリ(ジオクチルホスフェート)チタネー ト、イソプロピルトリクミルフェニルチタネート、イソ プロピルトリ(N-アミノエチル・アミノエチル)チタ ネート、ジクミルフェニルオキシアセテートチタネー ト、ジイソステアロイルエチレンチタネート等を挙げる

۲.

ことができる。これらに限定されるものではない。これらのカップリング剤の添加量は、本発明に用いるシール剤組成により大きく変化するが、エポキシ樹脂、硬化剤、硬化促進剤、充填剤の合計を 100重量部とした際、5重量部以下が好ましい。また、5重量部を越えると、樹脂の凝集力が低下し、結果として接着力や信頼性の低下する。

【0011】なお、本発明においては、必要に応じて他 の公知の添加剤を使用することが出来る。本発明の効果 を損なわない範囲であれば、何ら差し支えない。例え ば、アエロジルのような揺変剤、顔料、染料、可塑剤、 レベリング剤、消泡剤、反応性希釈剤などが挙げられ る。本発明の不純物は、シール剤組成物中に含まれるも のであり、硬化終了後、硬化組物中の分子量が小さく溶 剤抽出されやすいものをいう(例えば、未反応エポキシ 樹脂、未反応硬化剤、エポキシー硬化剤のアダクト生成 物やそれぞれ各構成材料自体に含まれている低分子物質 など)。不純物は、セルに液晶を封入した後、液晶に溶 け出し、滲みや原因となる(配向不良や表示不良を引き 起こす)。硬化物(1 mm φ 豆粒大)から不純物を下記 溶媒によって抽出した後、ガスクロマトグラムによって 不純物濃度として定量した。その不純物濃度が0.1重量 %を超えた場合、耐液晶性が悪く、液晶注入セル環境試 験で消費電流値が初期値の1.5倍を超え、表示不良とな る。不純物濃度が0.1重量%未満であれば、液晶注入セ ル環境試験で良好な特性を示すこととなる(溶媒をシー ル剤組成に含まないので不純物濃度を低く抑えることが 出来る)。(耐液晶性と相関)

不純物濃度を0.1 重量%未満とするには、種々の方法がある。例えば、シール剤組成物中の構成成分の純度が高い材料を使用する、シール剤組成物の構成成分を溶剤により予め抽出し、不純物濃度を低下させる、シール剤組成物をそれ自体に溶解しない溶剤で洗浄する、シール剤組成物の構成成分が液晶や上記抽出溶媒に溶解しにくい成分を使用する、硬化反応を促進し、低分子成分を低減するなどが挙げられるが、方法はいずれでも構わない。また、これら硬化物を抽出溶媒に浸漬した際に膨潤率

(重量変化率%) が変化する。膨潤することで、接着強度が低下する。液晶注入した際の膨潤率変化と相関があり、液晶セルの強度低下につながり、製品安定性が損なわれる恐れがある。10重量%を超えると、シール剤組成物によらず、接着強度は低下する。また、膨潤によって、硬化物中の低分子が溶出する割合が高くなり、耐液晶性の低下する割合が増加する。液晶注入セル環境試験で消費電流値が初期値の1.5 倍を超え、表示不良となる場合もある。膨潤率が10重量%以下であれば、液晶注入セル環境試験で良好な特性を示すこととなる。

【0012】膨潤率を10重量%以下とするには、種々の方法がある。例えば、シール剤組成物の硬化において、多官能エポキシ樹脂添加あるいは多官能硬化剤添加

٠...

によって架橋密度を向上させる、硬化温度を上げ、架橋 密度を向上する、硬化条件でステップキュア、アフター キュアすることで架橋密度を向上する、シール剤組成物 中に膨潤しない充填剤を添加するなどによって、硬化物 の膨潤を低減する方法が挙げられるが、これらはいずれ でも構わない。尚、本発明で用いる抽出溶媒としては、 具体的には、n-ヘプタン、n-オクタン、シクロヘキ サン、トルエン、n-ブチルエーテル、n-ヘキシルエ ーテル、エチルフェニルエーテル、1,4-ジオキサン、ジ エチルアセタール、アセトン、メチルエチルケトン、メ チルーn-ブチルケトン、シクロヘキサノン、酢酸エチ ル、酢酸ーnーブチル、メチルセロソルブ、メチルセロ ソルブアセテート、メチルカルビトール、エタノール、 メタノール、等が挙げられる。これらは、一種類であっ てもよいし、二種類以上を組み合わせて使用しても差し 支えない。なお、浸漬に使用する溶媒量は硬化物0.1g に対して、10gとした。更に、本発明の無溶剤型プラス チックフィルム液晶素子用シール剤を用いるプラスチッ クフィルム液晶素子の製造法を説明する。本発明で用い るプラスチックフィルム基板樹脂材料としては、ポリェ チレンテレフタレート(PET)、ポリブチレンテレフ タレート(PBT)、ナイロン、ポリアセタール(PO M)、ポリフェニレンスルフィド(PPS)、ポリエー テルエーテルケトン(PEEK)、液晶性ポリエステル (LCP)、ポリカーボネート(PC)、変性ポリフェ ニレンオキシド(変性PPO)、ポリアリレート(PA R)、ポリスルホン(PSF)、ポリエーテルスルホン (PES)、ポリエーテルイミド (PEI)、ポリアミ ドイミド(PAI)、ポリテトラフルオロエチレン(P TFE)、ポリイミド(PI)、ポリアミノビスマレイ ミド、トリアジン樹脂などが挙げられる。また、基板表 面は、透明電極(ITO 電極)や配向膜(ポリイミド系配 向膜)を付けたものでも、問題はない。

【〇〇13】前記無溶剤型プラスチックフィルム液晶素 子用シール剤を、スクリーン印刷、ディスペンサー等の 手法により、プラスチックフィルム基板の上に、適当な 膜厚に塗布し、乾燥炉等でプレキュアーさせる。その上 で、スペーサーとしてギャップ剤を散布したプラスチッ クフィルム基板を貼り合わせ、エアパッグ等で加圧しな がら、乾燥炉、送風恒温槽等の手段により加熱硬化させ る。なお、シール剤中の固形物最大粒径が5μm未満で あるときに特に良好なギャップ保持特性を示す。固形物 最大粒径が 5 μ m以上であるときはスクリーン印刷性が 低下する場合があり、更に固形物同士が二次凝集を起こ すことによりギャップ保持が困難になる場合があり好ま しくない。本発明におけるプレキュアーとは、シール剤 中に含有する溶剤や水分を揮発及びシール剤中の脱泡を させ、かつその後、プラスチックフィルム基板をあわ せ、加熱硬化させる際にシール剤が対向プラスチックフ ィルム基板の接着部分になじむようレベリングを行なう

ことである。プレキュアーの条件としては、気流中、室 温から130℃2分~2時間の範囲であり、生産性や経 済性及び硬化剤特性を考慮すると、60~110℃で2 ~30分の範囲が好適である。また、本発明における加 熱硬化は、シール剤中のエポキシ樹脂と潜在性硬化剤と の硬化反応を充分行なわせ、かつプラスチックフィルム 基板を接着させることを意味する。硬化条件としては、 気流中、90~130℃で30~480分であり、好ま しくは100~120℃で60~240分の範囲が好適 である。なお、硬化条件はステップキュアを行っても良 い(膨潤防止に効果)。例えば、100℃で圧着仮硬化 し、圧力フリー で120℃で本硬化するなどの多段階硬化 接着も行うことも可能である。このようなアフターキュ アすることで、硬化物の架橋密度向上による膨潤防止や 水分や被着有機物や染み出し不純物をエージングし、液 晶注入前のプレ処理になるという効果も出る。

【0014】以下に、合成例、実施例及び比較例により 本発明を詳細に説明する。以下において、「部」と 「%」は、重量基準である。なお、得られた無溶媒型プ ラスチックフィルム液晶素子用シール剤及び液晶表示素 子は、以下のような試験で評価した。

(シール剤評価方法)

(i) 不純物濃度測定法及び膨潤率測定法及び溶媒浸漬 接着試験

不純物濃度測定法はシール剤を所定温度所定時間で1m m ¢ の豆粒状に硬化したシール剤硬化物0. 1 g を溶媒と してアセトン10gに24時間浸漬し、不純物を抽出する。 抽出液中の不純物をガスクロマトグラフにより分析し、

(不純物ピーク面積/全ピーク面積) ×100 を抽出液中 の不純物濃度(重量%)とし、0.1重量%未満のものを 〇とした。膨潤率測定法は不純物濃度測定法と同様にア セトンに24時間浸漬し、重量変化率を膨潤率 (重量%) とし、10重量%以下のものをOとした。不純物濃度測定 法及び膨潤率測定法と耐液晶性相関をとり、不純物濃度 及び膨潤による影響を評価した。空液晶セルを作製し、 次のような評価を行った。

(ii) 耐液晶性:膨潤度、消費電流値が全て下記の条件 を満足するものを○とし、いずれか1つでも満足しない ものを×とした。

膨潤度:液晶中の浸漬テストでシール剤の重量変化が10 重量%以下

消費電流値:6 0℃-90%RHの環境保存テストを100 時間 実施後、消費電流値が初期値の1.5 倍以下

(iii) 接着性: 100μm厚のポリエチレンテレフタレ ートフィルムを、7μm厚でシール剤により接着し、20 mm/minの速度でピール強度を測定した。

O:200g/cm以上

 $\Delta:100\sim200gf/cm$

×:100g/cm以下

(iv) 接着信頼性:上記接着したサンプルを60℃-90%RH 及び85℃の環境保存テストを100 時間実施後、剥離試験 (ピール強度測定)を行った。

O:200g/cm以上

△:100~200g/cm

×:100g/cm以下

【0015】 (v) 印刷性:連続印刷性が良好なものを Oとする。

(vi) 染み出し(滲み):接着硬化後、シールパターン直 進性の良好なものを○とする。

(vii) 硬化温度:硬化温度が130℃以下のものを〇 とする。

(シール剤混練方法及び液晶セル作製方法) 各成分をへ ンシェルミキサーで混合し、セラミックス製三本ロール にて充填剤及び硬化剤の粒径が5μm 以下になるまで混 練し、シール剤を得た。ITO 透明電極の形成されたポリ エチレンテレフタレート(PET)フィルム基板を、ポリ イミド系配向剤を用いて配向処理し、その外周部にシー ル剤をシール部パターンに印刷し、所定温度、所定時間 プレキュアーし、室温まで冷却した。ついで、この基板 に同様に配向処理したPET フィルム基板をギャップ剤を 介して重ね合わせ、エアバッグにて圧着した後、所定温 度、所定時間加熱してシール剤を硬化せしめて両基板を 接着し、液晶としてLixon 6220 (チッソ (株) 製) お よびZLI -1565 (メルク社製) (カイラルネマチック液 晶C-15,0.5wt%含有) あるいは液晶としてLixon 620 O (チッソ(株)製)およびZLI -1800,000 (メルク社 製)(カイラルネマチック液晶 C-15, 0.5wt%含有)を 封入して液晶セルを作製した。

【0016】 (第1の実施例) 次のような組成を攪拌混 合し、更に3本ロールミルにて、前記方法で混練し、シ 一ル剤を得た。

ビスフェノールA型エポキシ樹脂(油化シュルエポキシ 社製、エピコート828) 100

重量部

2、4-ジ アミノー6- {2'-メチルイミダゾリルー(1')} ーエチルーsートリアジンイソシアヌル酸付加物 10重 量部 (四国化成社製:2MA-OK)

硬化促進剤:ジシアンジアミド

5重量

ポリマー粒子(コアシェル型アクリル粒子: 日本セ゚オン 社製:F351) 無機充填剤:TiO2(日本170ジル 社製:P25)

30重量部 10重量部

5重量部

: 無定型シリカ(日本エアロジル 社製:R972)

シランカップリング剤(信越シリコーン 社製:KBM403)

このシール剤を用い、前記セル作製方法にしたがい、プ リベーク条件:90℃2分、硬化条件: 1次硬化100 ℃3時間、アフターキュア130℃2時間で空液晶セル 及び豆粒硬化物を作製した。この空液晶セル及び豆粒硬 化物に対して、前記シール剤評価方法に従い、評価した 結果を表 1 に示した。豆粒硬化物は溶媒抽出による不純

全重量に対して3 重量%

物濃度0.1重量%未満の硬化物であった。

(比較例1)次のような組成を攪拌混合し、更に3本口 ールミルにて、前記方法で混練し、更に2-(2- エトキシ エトキシ) エタノール(溶剤) 10重量部を混合し、シール 剤を得た。

ピスフェノールA型エポキシ樹脂(油化シェルエポキシ社製、エピコート828)

ポリアミン変性アダクト(旭電化社製: アデカハードナーEH-4070S)

60重量部

このシール剤を用い、前記セル作製方法にしたがい、シ 一ル部印刷後、90℃30分溶剤乾燥し、プリベーク条 件:90℃2分、硬化条件:100℃2時間で空液晶セル 及び豆粒硬化物を作製した。この空液晶セル及び豆粒硬 化物に対して、前記シール剤評価方法に従い、評価した

結果を表1に示した。豆粒硬化物は溶媒抽出による不純 物濃度0.1 重量%以上の硬化物であった。

【0017】 (第2の実施例) 次のような組成を攪拌混 合し、更に3本ロールミルにて、前記方法で混練し、シ 一ル剤を得た。

ビスフェノールA型エポキシ樹脂(油化シュルエポキシ 社製、エピコート828)

100重量

7、11-オクタテ カシ エンー1、18-ジ カルボ ヒト ラジ ト

48 重

量部

ポリマー粒子(7クリル 粒子: 日本セ゚オン 社製:F301) 無機充填剤:TiO2(日本170ジル社製:P25)

10 重量部 10 重量部

無定型シリカ(日本エアロジル 社製:R972)

9 重量部

シランカップリング剤(信越シリコーン 社製:KBM403)

全重量に対して5 重量%

このシール剤を用い、前記セル作製方法にしたがい、プ リペーク 条件:90 ℃2分、硬化条件: 1次硬化100℃3 時間、アフターキュア130℃2時間で空液晶セル及び 豆粒硬化物を作製した。この空液晶セル及び豆粒硬化物 に対して、前記シール剤評価方法に従い、評価した結果

を表 1 に示した。豆粒硬化物は膨潤率10重量%以下の硬 化物であった。

(比較例2)次のような組成を攪拌混合し、更に3本口 ールミルにて、前記方法で混練し、更に2-(2-エトキシエトキシ) エタノール(溶剤)10重量部を混合し、シール剤を得た。

ビスフェノールA型エポキシ樹脂(油化シュルエポキシ 社製, エピコート828) 100 重量

尿素アダクト(富士化成社製:フジキュアFXE-1000)

25重量部

このシール剤を用い、前記セル作製方法にしたがい、テ ル 部印刷後、90℃30分溶剤乾燥し、プリペーク 条件: 9 0 ℃2分、硬化条件:130℃2時間で空液晶セル及び豆 粒硬化物を作製した。この空液晶セル及び豆粒硬化物に 対して、前記シール剤評価方法に従い、評価した結果を

表 1 に示した。豆粒硬化物は膨潤率10重量%以上の硬化 物であった。

【0018】 (第3の実施例) 次の組成を攪拌混合し、 更に3本ロールミルにて、前記方法で混練し、シール剤 を得た。

ピスフェノールA型エポキシ樹脂(油化シェルエポキシ 社製、エピコート828) 100重量部.

1、3-ピス(ヒドラジノカルポエチル)-5-イソプロピルヒダントイン (味の素社製:アミキュア**V**DH) 41

重量部 ポリマー粒子(コアシェル型アクリル粒子: 日本ゼオン 社製:F351) 20

無機充填剤:TiO2(日本170ジル 社製:P25)

10重量部

: 無定型シリカ(日本エアロジル 社製:R972)

9重量部

シランカップリング剤(信越シリコーン 社製:KBM403)

全重量に対して3 重量%

このシール剤を用い、前記セル作製方法にしたがい、プ リペーク 条件:90℃2分、硬化条件:1次硬化100℃2 時間、アフターキュア120℃2時間で空液晶セル及び 豆粒硬化物を作製した。この空液晶セル及び豆粒硬化物 に対して、前記シール剤評価方法に従い、評価した結果 を表1に示した。豆粒硬化物は溶媒抽出による不純物濃

度0.1 重量%未満、膨潤率10重量%以下の硬化物であっ

(比較例3) 実施例3の1、3-ピス(ヒト゚ラジノカルポエテル)-5-イソ プロピルヒダントインの代りに、硬化剤として尿素アダクト(富士 化成社製: フジキュアFXR-1030) 25 重量部を使用する以外は 同じ組成でシール剤を混練し、更に2-(2-エトキシエトキシ)エタノー

ル(溶剤)10重量部を混合し、シール剤を得た。このシー ル剤を用い、前記セル作製方法にしたがい、シル 部印刷 後、90℃30分溶剤乾燥し、プリペーク 条件:90℃2 分、硬化条件:130℃2時間で空液晶セル及び豆粒硬 化物を作製した。この空液晶セル及び豆粒硬化物に対し て、前記シール剤評価方法に従い、評価した結果を表 1

に示した。豆粒硬化物は溶媒抽出による不純物濃度0.1 重量%以上、影潤率10重量%以上の硬化物であった。 【0019】 (第4の実施例) 次の組成を攪拌混合し、 更に3本ロールミルにて、前記方法で混練し、シール剤 を得た。

ビスフェノールA型エポキシ樹脂(油化シュルエポキシ 社製 ユピコート828) 100重

量部

1、3-ピス(ヒト゚ラジ/カルポエテル)-5-イソプロピルヒダントイン (味の素社製:アミキュアVDH)

重量部

硬化促進剤:

2、4-ジアミノ-6- 【2゚ーメテルイモダゾリルー(1゚)} ーエテルーsートリアジン(四国化成社製:2MZ-A)

1 重量部

ポリマー粒子(コアシェル型アクリル粒子: 日本ゼオン 社製:F351) 30重量部

無機充填剤:TiO2(日本170ジル 社製:P25) 10重量部

: 無定型シリカ(日本エアロジル 社製:R972) 5重量部

シランカップリング剤(信越シリコーン 社製:KBM403)

全重量に対して3 重量%

このシール剤を用い、前記セル作製方法にしたがい、プ リペーク 条件:90℃2分、硬化条件:1次硬化100℃2 時間、アフターキュア110℃2時間で空液晶セル及び 豆粒硬化物を作製した。この空液晶セル及び豆粒硬化物 に対して、前記シール剤評価方法に従い、評価した結果 を表 1 に示した。豆粒硬化物は溶媒抽出による不純物濃 度0.1 重量%未満、膨潤率10重量%以下の硬化物であっ t:。

(比較例4) 実施例4の1、3-ピス(ヒドラジノカルポエチル)-5-イソ プロビルヒタ゚ントインの代りに、硬化剤としてポリアミン 変性アダク ト(旭電化社製: アデ カハード ナ-EH-3731S) 60重量部を使用する 以外は実施例2 と同じ組成でシール剤を混練し、更に2-

(2-エトキシエトキシ)エタノール(溶剤)10重量部を混合し、シール剤 を得た。このシール剤を用い、前記セル作製方法にした がい、シール 部印刷後、90℃30分溶剤乾燥し、プリペーク 条 件:90℃2分、硬化条件:100℃2時間で空液晶セ ル及び豆粒硬化物を作製した。この空液晶セル及び豆粒 硬化物に対して、前記シール剤評価方法に従い、評価し た結果を表 1 に示した。豆粒硬化物は溶媒抽出による不 純物濃度0.1 重量%以上、膨潤率10重量%以上の硬化物 であった。

【0020】 (第5の実施例) 次の組成を攪拌混合し、 更に3本ロールミルにて、前記方法で混練し、シール剤 を得た。

20重量部

10重量部

ビスフェノールA型エポキシ樹脂(油化シェルエポキシ 社製、エピコート828) 80重量部 ポリスルフィド変性エポキシ樹脂(東レ・チオコール 社製、FLEP50) 20 重量部 1、3-t゚ス(ヒト゚ラジノカルポエチル)-5-イソプロビルヒダントイン (味の素社製:アミキュアVDH) 量部

ポリマー粒子(コアシェル型アクリル粒子: 日本ゼオン 社製:F351) 無機充填剤:TiO2(日本17Dジル 社製:P25)

> : 無定型シリカ(日本エアロジル 社製:R972) 5重量部

シランカップリング 剤(信越シリコーン 社製:KBM403) 全重量に対して3 重量%

このシール剤を用い、前記セル作製方法にしたがい、プ リペ-ク 条件:90℃2分、硬化条件:1次硬化100℃2時 間、アフターキュア120℃2時間で空液晶セル及び豆 粒硬化物を作製した。この空液晶セル及び豆粒硬化物に 対して、前記シール剤評価方法に従い、評価した結果を 表 1 に示した。溶媒抽出による不純物濃度0.1 重量%未 満、膨潤率10重量%以下の硬化物であった。

(比較例5) 実施例5の1、3-t'ス(tト゚ラジ/カルポエテル)-5-イソ プロピルヒダントイン (味の素社製:アミキュアVDH)の代りに、硬化 剤として尿素79° クト(富士化成社製: フジキュアFXR-1030) 25 重量部を使用し、ポリスルフィド変性エポキシ樹脂(東レ ・チオコール 社製、FLEP50)を使用しない以外は実施例5と同

A ...

じ組成でシール剤を混練し、更に2-(2-エトキシエトキシ)エタノール (溶剤)10重量部を混合し、シール剤を得た。このシール 剤を用い、前記セル作製方法にしたがい、シール 部印刷 後、90℃30分溶剤乾燥し、プタペ-ク 条件:90℃2 分、硬化条件: 130℃2時間で空液晶セル及び豆粒硬化 物を作製した。この空液晶セル及び豆粒硬化物に対し て、前記シール剤評価方法に従い、評価した結果を表1 に示した。豆粒硬化物は溶媒抽出による不純物濃度0.1 重量%以上、影潤率10重量%以上の硬化物であった。 【0021】(第6の実施例)次の組成を攪拌混合し、 更に3本ロールミルにて、前記方法で混練し、シール剤

70重量

ビスフェノールA型エポキシ樹脂(油化シュルエポキシ 社製、エピコート828)

を得た。

1 1000

部

ポリエーテルグリコール型エポキシ樹脂(三洋化成社製、グリシエール8PP350) 30 重量部

1,3-t'ス(tドラジノカルボエチル)-5-イソプロビルヒダントイン (味の素社製:7ミキュアVDH) 33 重母部

* リマー粒子(コアシェル型アクリル粒子: 日本ゼオン 社製:F351)

30 重量部

無機充填剤:TiO2(日本170ジル 社製:P25)

10重量部

: 無定型シリカ(日本エアロジル 社製:R972)

5重量部

シランカップリンク゚ 剤(信越シリコーン 社製:KBM403)

全重量に対して3 重量%

このシール剤を用い、前記セル作製方法にしたがい、プリペーク条件:90℃2分、硬化条件:1次硬化100℃2時間、アフターキュア120℃2時間で空液晶セル及び豆粒硬化物を作製した。この空液晶セル及び豆粒硬化物に対して、前記シール剤評価方法に従い、評価した結果を表1に示した。溶媒抽出による不純物濃度0.1 重量%未満、膨潤率10重量%以下の硬化物であった。

(比較例6) 実施例6の1、3-ピス(ヒドラジノカルポエテル)-5-イッ プロピルヒダントイン (味の素社製:アミキュアVDH)の代りに、硬化剤として酸無水物系硬化剤(旭電化社製:アテ゚カハート゚ナーEH-3 326)85 重量部を使用し、ポリエーテルグリコール型エポキシ樹脂(三洋化成社製,グリシエールBPP350)を使用しない以外は実施例6と同じ組成でシール剤を混練し、更に2-(2-エトキシエトキシコエタール(溶剤)10重量部を混合し、シール剤

を得た。このシール剤を用い、前記セル作製方法にしたがい、シール部印刷後、90℃30分溶剤乾燥し、プリハーク条件:90℃2分、硬化条件:130℃2時間で空液晶セル及び豆粒硬化物を作製した。この硬化温度では未硬化だったので、硬化可能な温度150℃まで上昇させて、空液晶セルを作製したが、この硬化温度ではプラスチックフィルム基板が湾曲し、セルギャップを維持することができなかった。硬化条件:130℃2時間の空液晶セル及び豆粒硬化物に対して、前記シール剤評価方法に従い、評価した結果を表1に示した。豆粒硬化物は溶媒抽出による不純物濃度0.1重量%以上、膨潤率10重量%以上の硬化物であった。

【表1】 シール剤評価

	不純物濃度	庭潤率	耐液晶性	接着性	接着信頼性	印刷性	染み出し (滲み)	硬化温度
実施例 1	0	0	0	0	0	0	0	0
実施例 2	0	0	0	0	0	0	0	0
実施例 3	0	0	0	0	0	0	0	0
実施例 4	0	0	0	0	0	0	0	0
実施例 5	0	0	0	0	0	0	0	0
実施例 6	0	0	0	0	0	0	0	0
比較例 l	×	×	X	×	×	0	×	0
比較例 2	×	×	×	Δ	×	0	×	0
比較例 8	×	×	×	Δ	Δ	0	×	0
比較例 4	х	Х	Х	×	×	0	×	0
比較例 5	×	×	×	Δ	Δ	0	×	0
比較到 6	X	×	×	×	×	0	×	×

*比較例は溶剤を添加した組成物。また、比較例6は未 硬化であった。

#828 : ビスフェノールA型エポキシ樹脂(油化シェルエポキ シ 社製)

FLEP50:ポリスルフィド変性エポキシ樹脂(東レ・チオコール 社製)

BPP350: ポリエーテルグリコール型エポキシ樹脂(三洋 化成社製)

2MA-OK: 2、4-ジ 7ミ/-6- [2'-メチルイミダゾリルー(1')] -エチルーs -トリアジンイソシアヌル酸付加物(四国化成社製)

2MZ-A : 2、4-ジ 7ミノ-6- [2'-メチルイモタ゚ソ゚リルー(1')] -エチルーs -トリアジン(四国化成社製)

DICY: ジ シアンジ アミド

VDH : 1、3-t* ス (tドラジノカルボエテル)-5-イソプロピルヒタ゚ントイン (味の素社製)

EH-4070S: ポリアミン 変性アタ゚クト(旭電化社製)

ODH: 7, 11-1797 hy IV-1, 18-9 hat by 50 h

FXE-1000: 尿素アダクト(富士化成社製)
FXR-1030: 尿素アダクト(富士化成社製)
EH-3731S: ポリアミン 変性アダクト(旭電化社製)

【 O O 2 2 】 (第7の実施例) 前記実施例 1 − 6で作製した空液晶セルに、液晶 (Lixon 6200 (チッソ (株) 製) およびZLI −1800,000 (メルク社製) (カイラルネマチック液晶 C −15,0.5wt%合有)) 封入して、液晶セルを作製した。また、これらの液晶セルに対して、85℃および60℃−90%RHの環境保存テストを500時間行ったところ、その経過後も耐液晶性、接着信頼性は良好であった(表 2)。

(比較例7)前記比較例1-6で作製した空液晶セルに、 実施例7と同様にして液晶セルを作製し、環境保存テストも行った(表2)。なお、シール剤が硬化及び接着しないものがあり、空液晶セルが作製できないものもあっ た。更に85℃で500時間放置及び60℃で90%R Hの環境下に500時間放置した後の液晶パネルには、 剥離が生じたり、電流を測定することはできないものも あった。

【表2】 環境保存テスト

	85°C,500h	85°C、600h	60 °C -90%RH 、	60 °C -90%RH 、
	接着信頼性	耐液晶性	500h、接着信賴性	500h、耐液晶性
実施例 1	0	0	0	0
実施例 2	0	0	0	0
実施例3	0	0	0	0
実施例 4	0	0	0	0
実施例 5	0	0	0	0
実施例 6	0	0	0	0
比較例 2	×	×	Х	×
比較例3	×	×	Δ	X
比較例 5	×	×	. Δ	×

#828 : ビスフェノールA型エポキシ樹脂(油化シュルエポキ シ 社製)

FLEP50:ポリスルフィド変性エポキシ樹脂(東いチオコール 社製)

BPP350: ポリエーテルグリコール型エポキシ樹脂(三洋 化成社製)

2MA-OK: 2、4-ジアミノ-6- {2'-メチルイミダゾリル-(1')} -エテルーs -トリアジンイソシアヌル酸付加物(四国化成社製)

2MZ-A : 2、4-ジアミノ-6- {2'-メチルイモダゾリル-(1')} -エチルーs -トリアジン(四国化成社製)

DICY : ジ シアンジ アミド

VDH : 1、3-ピス(ヒドラジノカルポエチル)-5-イソプロピルヒダントイン(味の索社製)

ODH: 7, 11-オクタデ カシ エン-1, 18-ジ カルボ ヒト ラジ ト

[0023]

...

【発明の効果】本発明のシール剤を用いることにより、 作業性の良好な、プラスチックフィルム基板に対する接 着強度に優れ、基板の熱変化に対する追従性、液晶、水 分、熱等に対する物理的・化学的安定性の良好な、硬化 時及び硬化後の滲み、膨潤を防止した信頼性の高い無溶 剤型プラスチックフィルム液晶素子用シール剤及びそれ を用いた液晶表示素子を提供することことが出来る。請 求項1の発明では、エポキシ樹脂、潜在性硬化剤及び充 填剤を主成分として含有する無溶剤型プラスチックフィ ルム液晶素子用シール剤であり、該プラスチックフィル ム液晶素子用シール剤硬化後の溶媒抽出における不純物 濃度が0.1 重量%未満であることで、液晶、水分、熱等 に対する物理的・化学的安定性の良好な、硬化時及び硬 化後の滲み、膨潤を防止した無溶剤型プラスチックフィ ルム液晶素子用シール剤を提供することが出来る。請求 項2の発明では、エポキシ樹脂、潜在性硬化剤及び充填 剤を主成分として含有する無溶剤型プラスチックフィル ム液晶素子用シール剤であり、該プラスチックフィルム 液晶素子用シール剤硬化後の溶媒抽出における膨潤率が 10重量%以下であることで、液晶、水分、熱等に対する 物理的・化学的安定性の良好な、硬化時及び硬化後の滲 み、膨潤を防止した無溶剤型プラスチックフィルム液晶 素子用シール剤を提供することが出来る。請求項3の発 明では、潜在性硬化剤として、少なくとも2塩基酸ジヒ ドラジドを含有することで、更にプラスチックフィルム 基板への接着性を増加させ、滲み、膨潤を防止した硬化 を可能とする無溶剤型プラスチックフィルム液晶素子用 シール剤を提供することが出来る。請求項4の発明で は、潜在性硬化剤が少なくとも、1、3-ビス(ヒドラ ジノカルポエチル) -5-イソプロピルヒダントインを 含有することで、特に低温硬化を可能にし、プラスチッ クフィルム基板への熱的負担を軽減した接着を可能と し、低コスト化することができる無溶剤型プラスチック フィルム液晶素子用シール剤を提供することが出来る。 【〇〇24】請求項5の発明では、エポキシ樹脂が少な くとも可撓性エポキシ樹脂を含有することで、硬化物に 可撓性を付与し、更にプラスチックフィルム基板への接 着性を向上させることが出来る無溶剤型プラスチックフ ィルム液晶素子用シール剤を提供することが出来る。請 求項6の発明では、可撓性エポキシ樹脂が少なくともエ ポキシ樹脂として、両末端にグリシジル基を有し、分子 中に(R-O)n基(但し、Rはアルキレン基、nは1 以上を示す)を少なくとも1つ以上有するエポキシ化ポ リエーテルグリコールを含有するエポキシ樹脂をシール 剤組成物中に含むことで、硬化物に可撓性を付与し、柔 軟なプラスチックフィルム基板への接着性を向上し、更 に潜在性硬化剤を配合することでポットライフを長くす る無溶剤型プラスチックフィルム液晶紫子用シール剤を 提供することが出来る。請求項7の発明では、上記無溶 剤型プラスチックフィルム液晶素子用シール剤を用いる ことで、より高い信頼性を有し、液晶、水分、熱等に対 する物理的・化学的安定性が良好で、滲み、膨潤を防止 でき、その上低温硬化及びポットライフ向上ができるた め、生産性の高い工程が可能とする安価な、軽く、薄 く、屈曲性のあるプラスチックフィルム液晶表示素子を

提供することが出来る。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

COBL 63/00

GO2F 1/1333

500

CO8L 63/00 GO2F 1/1333

500

С

Fターム(参考) 2H089 MAO4Y MAO5Y PA19 QA12

SA17 TA01

2H090 JB03 LA03

4J002 BB032 BB122 BC022 BD042

BF022 BG042 BG062 CC032

CC162 CC182 CC192 CC202

CD002 CD011 CD012 CD021

CD051 CD061 CD081 CD131

CD201 CF002 CK022 CP032

DC008 DE108 DE118 DE138

D0000 D2100 D2110 D2100

DE148 DE238 DG048 DJ008

DJ018 DJ028 DJ038 DJ048

DJ058 E0026 ER026 ER027

ET006 ET007 ET017 EU116

EU117 FA082 FA088 FD012 FD018 FD146 FD157 GJ02

4J036 AA05 AB07 AB10 AD08 AD20

AF06 AG03 AH04 AJ08 CD09

CD15 CD22 DA05 DA10 DC01

DC05 DC25 DC31 DC35 DC40

FA01 FB02 FB03 FB09 FB10

FB11 FB13 FB16 JA07 KA01

**...